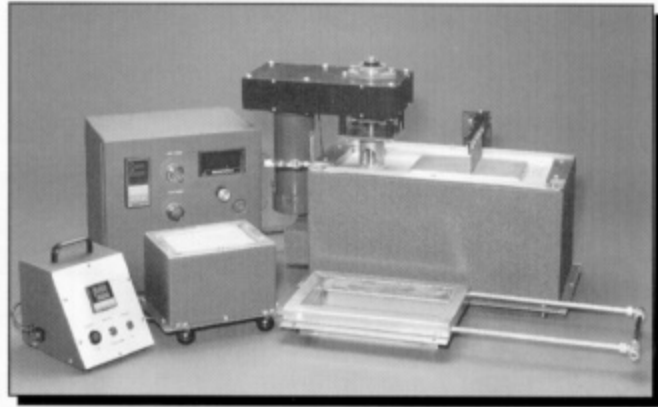


# Solder Pots

## Static and Dynamic Models

### 特點

- 瀑布式, 波浪式, 噴泉式 及 靜止式
- 所有均採用優質不銹鋼製造
- 堅固絕緣的陶瓷物料
- 優良的溫度控制消除溫度不平均的現象
- 可用特別設計的夾具來焊接晶片
- 所有型號可配合氮氣使用
- 自動撇除錫漿表面浮渣的裝置
- 溫度最高可達攝氏400度
- 動態錫爐的驅動器速率為 $\pm 2$  RPM
- PID 溫度控制  $\pm 3$



### 說明

- RPS錫爐是一套完善的鍍錫系統, 而它有兩種鍍錫系列分別是靜態(Static)與動態(Dynamic), 堅固耐用使用壽命時間長, 全部均採用優質不銹鋼以及取得專利的陶瓷絕緣物料製造, 在爐內有一個特別設計的支撐架用來承托加熱元件, 強化底部以免加熱時機殼出現曲面的情況, 所以這是一個既安全又耐用的鍍錫系統, 而且RPS錫爐可以二十四小時循環加熱至攝氏482 ,亦被MTBF應可使用6000小時。
- 兩種錫爐都有PID比例溫度控制顯示於兩個顯示器上, 一個顯示設定點, 另一個讀出實際溫度, 靜態(Static)錫爐能控制溫度 $\pm 3$  (Dynamic) 錫爐能控制溫度 $\pm 2$  , 在重複過程時都能準確地保持溫度控制, 動態的錫爐亦特別設計消除製作過程時溫度下降的因素, 保持錫爐的錫漿不會凝固。
- 動態的錫爐特設一個DC(直流)驅動的馬達由錫爐控制速度, 這是一套由不銹鋼製造的驅動器用泵漿將錫漿穿過三個不同階段, 而這個階段可令到錫漿絕對平滑平坦(0.05")波浪, 要保持整個錫爐溫和平衡。動態錫爐的錫漿同樣會產生氧化只要簡單地增加流動的速度就可把氧化物清除, 而動態錫爐它亦可變為靜態的錫爐, 只要把流動速度設定點轉為"0"便可變為靜態的錫爐。

### 晶片夾具

- 可為錫爐裝上特別設計的晶片夾來使用, 所有靜態型號安裝容易耐用, 全部均採用不銹鋼及特別的絕緣物料製造, 加強加熱的電熱元件及PID 比例溫度控制設定點 $\pm 3$  . 附加自動撇除浮渣裝置, 短暫停止和顯示警告, 提示開啟電熱偶及加熱器。

### 氮氣裝置

- 大部份型號都特別提供氮氣裝置, 在一個有效而不防礙鍍錫過程的環境下裝上一個覆蓋多方面的氮氣擴散器, 這個作用有助消除鍍錫時所出現的 "bridging" 及 "icicling" 問題, 最後塗上松脂更可增加鍍錫後的光澤。

### 自動撇除浮渣裝置

- 所有RPS錫爐都已安裝一個撇除錫漿表面的氧化物及浮渣裝置。

